## 智慧机房 V2.0 - 功能 #1235

任务 # 1220 (完结): 无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

功能 # 1231 (完结): 3. 管理模块PCB改进

## 1. PCB板改进

2017-10-28 11:27 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2017-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-12
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

## 描述

在原管理模块基础上,改用新的增强型MCU,增加显示屏(SPI及IIC接口), 改用防震动接插件.....

## 历史记录

#1 - 2017-10-28 11:58 - 韦士飞

- 指派给 被设置为 盘 贵星

#2 - 2017-10-28 11:59 - 韦士飞

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#3 - 2017-10-28 12:00 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 20

2017.10.27 已建议小盘对于SPI、IIC总线接线按芯片本身硬件支持总线进行布线修改。

#4 - 2017-10-28 12:52 - 盘 贵星

2017-10-28已完成布局, PCB下单,物料采购,尚有电源模块及外壳胶贴未下单。

#5 - 2017-11-01 10:40 - 韦士飞

PCB样板已到,正安排焊接。预计两天可完成焊接。

#6 - 2017-11-02 10:26 - 韦士飞

IIC接口IO为真开漏输出,其IO属性为高阻态。需外接上拉电阻之后才能做为有效IO接口,以驱动外设。 需对此做改进。

#7 - 2017-11-03 10:34 - 韦士飞

测试中发现模块串口通道切换与MCU连接的串口驱动能力欠缺,需增加上拉。

#8 - 2017-11-09 09:38 - 盘 贵星

2017-11-91、已经完成增加2个上拉电阻修改。

#9 - 2017-11-09 09:38 - 盘 贵星

- % 完成 从 20 变更为 100

#10 - 2017-11-12 10:39 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为2017-11-12
- 类别 被设置为 硬件
- 状态 从 已发货 变更为 调试中

2025-04-04 1/2

#11 - 2017-11-16 10:15 - test u3

- 状态 从 调试中 变更为 完结

2025-04-04 2/2